

# 三次元積層実装勉強会の企画・開催について(開催スケジュール)

会員限定・参加無料

**令和7年度勉強会** 申し込み方法は、総会後にメール・ウェブサイトで事務局より案内します

令和7年度 三次元積層実装勉強会

※開催日については随時更新

2025年5月19日現在

コース	No.	題 目	6月～9月	10月～3月			
入門	1	半導体概論 <対面+オンライン>	半導体概論 6月17日	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和7年度より、会員の三次元積層実装産業への関心の醸成や、三次元積層LSIに対する理解の促進を目的として、勉強会を企画・開催</li> <li>勉強会は、これまでに訪問した地域企業の皆様の声をもとに、入門レベル・初級レベルから体系的・技術的な理解を深めていただく機会として企画します</li> </ul>			
	2	半導体前工程プロセス (①～③) <対面+オンライン>	<table border="1"> <tr> <td>半導体前工程 プロセス① 6月24日</td> <td>半導体前工程 プロセス② 7月8日</td> <td>半導体前工程 プロセス③ 7月22日</td> </tr> </table>		半導体前工程 プロセス① 6月24日	半導体前工程 プロセス② 7月8日	半導体前工程 プロセス③ 7月22日
	半導体前工程 プロセス① 6月24日	半導体前工程 プロセス② 7月8日	半導体前工程 プロセス③ 7月22日				
3	半導体後工程プロセス (①～③) <対面+オンライン>	<p>&lt;半導体前工程プロセス・後工程プロセスは同日に開催&gt;</p> <table border="1"> <tr> <td>半導体後工程 プロセス① 6月24日</td> <td>半導体後工程 プロセス② 7月8日</td> <td>半導体後工程 プロセス③ 7月22日</td> </tr> </table>	半導体後工程 プロセス① 6月24日	半導体後工程 プロセス② 7月8日	半導体後工程 プロセス③ 7月22日		
半導体後工程 プロセス① 6月24日	半導体後工程 プロセス② 7月8日	半導体後工程 プロセス③ 7月22日					
初級	1	三次元積層実装 (仮称)		三次元積層実装 (仮称) 10～12月頃			
	2	TSV形成技術 (仮称)		TSV形成技術 (仮称) 10～12月頃			
	3	三次元積層実装適用事例		三次元積層実装適用事例 11～1月頃			

日程が確定した勉強会